

ZO-HCG6050 导热硅胶片

产品介绍

ZO-HCG系列导热硅胶片，具有良好的导热性能，在相对较低的压力下就可以实现低界面热阻性能。应用于功率器件与散热铝片或机器外壳间，可以有效的排除空气，达到很好的填充效果。

ZO-HCG6050具有良好的柔软性能、回弹性，以及良好的绝缘耐压特性和热稳定性，使用安全、可靠。

性能参数

项目	单位	HCG6050	测试标准
颜色	-	灰色	目测
厚度	mm	0.5~3	ASTM D374
密度	g/cc	3.4+/-0.2	ASTM D792
硬度	Sc	30~60	ASTM D2240
导热系数	W/m.K	6.0	ASTM D257
热阻	@20PSI&1mm °Cin ² /W	1.8	ASTM D5470
击穿电压	KV(1.0mm)	6	ASTM D149
体积电阻率	Ω.cm	8.6*10 ⁹	ASTM D257
压缩比	%50PSI	45	ASTM D575-1991
拉伸强度	MPa	0.1	ASTM D412-1998A
延伸率	%	20	ASTM D412-1998A
介电常数	@1MHz	5.76	ASTM D150
介质损耗	-	0.00190	ASTM D150
防火性能	-	V-0	UL 94
热失重	%(120°C, 7d)	0.17	ASTM E595-2006
使用温度	°C	-40~150	-

产品特性

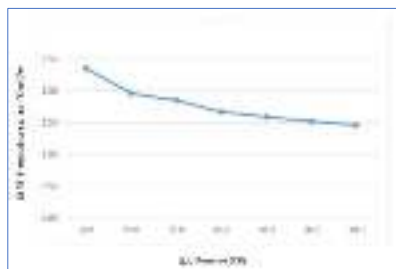
- ✓ 6.0W/m.k 导热系数，热阻抗性小
- ✓ 低压力应用，表面自粘性
- ✓ 防火性能高
- ✓ 良好的电绝缘性能和耐高温性能



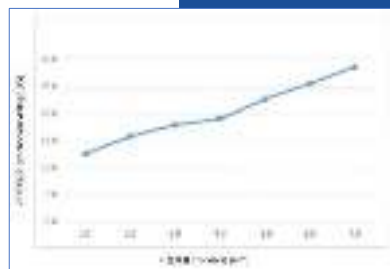
产品应用

- ✓ 移动电子设备
- ✓ 微处理器及芯片
- ✓ 笔记本电脑、汽车引擎控制单元
- ✓ 无线通讯硬件产品

产品热阻与压力关系图



产品击穿电压与厚度关系图



产品压缩率与压力关系图

